<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>値</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>形式</td>
<td>VT-X700-M</td>
</tr>
<tr>
<td>CD規格</td>
<td>H04EK36-JA-2200</td>
</tr>
<tr>
<td>柔軟度</td>
<td>フラット型</td>
</tr>
<tr>
<td>径厚 (mm)</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>高速度（mm）</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>下限速度（mm）</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>転送速度 (mm/min)</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>転送速度 (mm/min)</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>転送方向</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>柔軟度スイッチ</td>
<td>標準仕様</td>
</tr>
<tr>
<td>柔軟度スイッチ</td>
<td>高速仕様</td>
</tr>
<tr>
<td>機械容量</td>
<td>200kg</td>
</tr>
<tr>
<td>使用温度</td>
<td>-10°C 〜 +50°C</td>
</tr>
<tr>
<td>湿度</td>
<td>20% 〜 80%</td>
</tr>
<tr>
<td>機械高さ</td>
<td>3500</td>
</tr>
<tr>
<td>機械長さ</td>
<td>3500</td>
</tr>
<tr>
<td>機械幅</td>
<td>3500</td>
</tr>
<tr>
<td>機械重量</td>
<td>750kg</td>
</tr>
<tr>
<td>機械重量</td>
<td>750kg</td>
</tr>
<tr>
<td>機械重量</td>
<td>750kg</td>
</tr>
<tr>
<td>機械重量</td>
<td>750kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

外形寸法図
BGA部品をはじめ、下面電極部品のはんだを検査。X線CTだから接合面に強い。

 Needs
信頼性・生産性・使いやすさ。
これからの製造ラインに求められる課題です。

信頼性
信頼性・生産性・使いやすさの課題に、
VT-X700は、CT検査による3次元検査で対応。
自動検査アルゴリズムによる自動検査や、インタラクティブ検査に対応した
高度性・使いやすさGUIという3つのイノベーションで、
不良判定の基となった部品検査を大きく効率化します。

 Innovation
課題を解決する
オムロンの3つのイノベーション

1 高精度X線CT端末を採用
3次元CT端末がAlゴリズムの構築により
高精度な自動検査を可能に。
CT端末と検査アルゴリズムによって、検査面の分離・特定まで
誤み込みを減らし、検出精度を上げ、高精度基準
が明確になった画像検査で、迅速さや可読性を向上。

2 SMT業界最速クラス
効率的X線検査手法の確立で
急速検査を実現
インライン検査を実現するために、高速性
能を実現、15mm×15mmのBGA部品で
20秒という高速性で、生産ラインに影響
ないインライン完全自動検査実現

3 わかりやすいGUIで全数検査を視覚化
部品の見えない部分の良否判定もカンタン操作
BGA部品の組立部品、見えない部分の検査結果の確認や
判定基準の設定なども、実装するGUIでわかりやすくて複雑な
判定・操作を、すぐに活用いただけます。